

2026 年 3 月期 中間決算説明会 質疑応答（抜粋）

質問 1. D I 露光装置について、御社の立ち位置を教えてください。

（回答）AI 半導体用パッケージに使われる有機基板向け露光装置でトップシェア獲得を目指しています。台湾の半導体メーカーを中心とする OSAT 市場もさらに開拓したいと考えています。

半導体パッケージの微細化や大型化に向けて、最適なソリューションを提供できる製品ラインナップの整備を進めており、開発中の 0.5 μ m 対応装置は、FPD 用マスクライター開発で培った技術を応用していきます。

質問 2. インドの液晶関連プロジェクトの進捗と今後の見通しは？

（回答）インドのプロジェクトはこれまで何度か遅延してきましたが、関係者の話によると今期中にインド政府の予算が決まる見込みということで、期待感が強まっています。

質問 3. （サブセグメントの）半導体が堅調な背景は？

（回答）シリコンウェハ市況は厳しいものの、品質向上投資の需要が一定程度ございます。他に、大規模投資を検討する顧客において、当社の新原理の検査装置が有力候補に挙がっており、来期以降の採用・展開を見込んでいます。

質問 4. （サブセグメントの）フォトマスクの動向は？

（回答）レガシー半導体分野は、市況影響で投資判断が遅れる傾向にありますが、中国の新興メーカー向けを含め、ビジネスは確実に立ち上がりつつあります。量産が本格化すればさらなる拡大が見込めます。

質問 5. 注力中の AI 関連のパッケージサブストレートでの御社の強みは？サブストレート全般についてはいかがでしょうか。

（回答）AI 用半導体のパッケージ基板の量産および試作用として業界トップクラスの採用実績が強みと言えます。また、4 μ m 相当の回路が必要とされるパッケージサブストレートの量産に向けた投資が来年から本格化するとみています。その為、サブストレート全般では AI 関連(アドバンスドパッケージ)用の 4 μ m 以下に注力し、その他は協業で対応いたします。

質問 6. 来期の売上高 660 億円に向け、下期の受注について教えてください。

（回答）下期にかけて複数の主要案件の受注を見込んでおり、FPD と半導体フォトマスクがほぼ半々の構成になる見通しです。

質問 7. 決算説明資料にアドバンスドパッケージの一部案件が下期に延伸とございました。背景等を教えてください。

（回答）一部で延伸が御座いましたが、それに対応するリカバリー案件が出てきており、これを確実に獲得していく計画です。

質問 8. V ダイサーの動向について現状を教えてください。

（回答）様々なお客様から、ガラスやシリコン等、各種サンプルをお預かりしています。加工検証を進め、来期以降どこにフォーカスしていくのかを決めてまいります。

以上

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。